

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司控股子公司厦门华联半导体科技有限公司（以下简称“华联半导体”）基于经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“农业银行”）申请授信额度为最高不超过人民币 1,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、跨境参融通、衍生交易、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种）。

公司同意为该笔授信事项提供连带责任担保，担保金额最高额不超过人民币 1,200 万元（含），具体担保措施、担保期限等内容最终以实际签署的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向中国农业银行申请授信提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：厦门华联半导体科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 14 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 100 号恒业楼 208 室-93

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 100 号恒业楼 208 室-93

注册资本：38,000,000 元

主营业务：半导体器件制造

法定代表人：付智俊

控股股东：厦门华联电子股份有限公司

实际控制人：伍锐

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：96,617,857.75 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：85,668,295.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：10,949,562.65 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：88.67%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：88.67%

2023 年 12 月 31 日营业收入：58,436,295.88 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-11,943,715.87 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-9,050,437.35 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司作为华联半导体的保证人，为农业银行与华联半导体形成的债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 1200 万元，保证的范围包括尚未受偿的债

权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等。本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与农业银行共同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展的需要，华联半导体向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为华联半导体提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展，满足资金的需求，符合全体股东利益。华联半导体具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保有利于保障公司及控股子公司业务的顺利开展，有利于公司持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,700.00	9.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,700.00	9.91%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日